

ГОДОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

} за 2025 год

16 апреля 2026 года

gkelement.ru



ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

01

Данная презентация и материалы, а также информация, содержащаяся в них, не являются предложением ценных бумаг или офертой в отношении ценных бумаг, а также не являются рекламой ценных бумаг в РФ или иных юрисдикциях.

Данная презентация и материалы, а также информация, содержащаяся в них, не являются и не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений; они не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не составляют ее часть; они не являются инвестиционным консультированием или личной, индивидуальной или какой-либо иной рекомендацией или советом (в том числе в значении Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

02

Информация, содержащаяся в настоящей презентации и материалах, может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности ПАО «Элемент» («Компания») и группы Компании.

Фактические события, расчеты, результаты их деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов – общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности.

03

Компания или лица, входящие в группу Компании, их директора, акционеры (участники), сотрудники и представители / не предоставляет каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в данной презентации или связанных с ней материалах сведений и информации, и не берет на себя каких-либо обязательств по поддержанию их актуальности.

04

Данная презентация и материалы могут содержать информацию, относящуюся к другим лицам, компаниям и организациям, осуществляющим деятельность в той же отрасли, в которой осуществляет деятельность Компания и её группа.

Эта информация основана на общедоступных данных, известных Компании на момент подготовки настоящей презентации и материалов, и не может служить источником

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ЭЛЕМЕНТ
ГРУППА КОМПАНИЙ



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ — ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО



Микроэлектроника
и фотоника



Средства
отечественного
производства

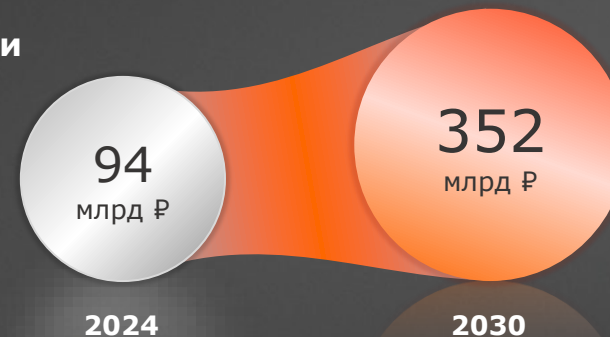


Приоритетные
направления научно-
технического развития
по созданию новых
технологий

Источники: Основы государственной политики, Указ № 344 от 12.05.2023 г., Указ №309 от 07.05.2024 г., Указ №529 18.06.2024 г.

Базовый сценарий
развития рынка
российской
микроэлектроники
до 2030 г.

25% СГТР¹



(1) По данным исследования «Перспективы развития рынка микроэлектроники в РФ на горизонте до 2030 г.», июнь 2025 г., СГТР указан для доли российских компаний на внутреннем рынке

Основные цели и задачи до 2030 г.

6 300 млрд руб.

объем реализации российской радио-электроники

70%

доля российских средств производства

70%

доля российской радио-электроники на внутреннем рынке

До 2%

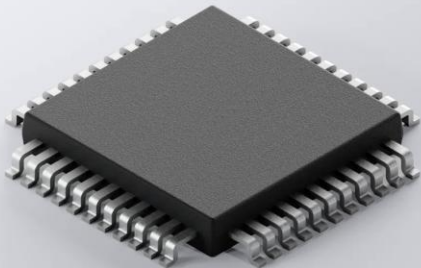
затраты на исследования и разработки не менее чем до 2% ВВП



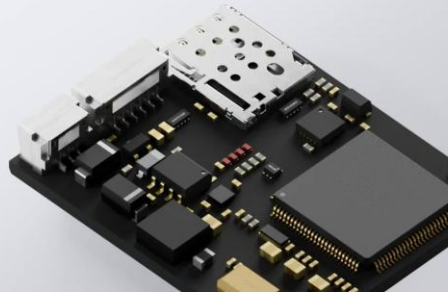
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2025 ГОДА

Электронно-компонентная база

Продажа **1 млн микроконтроллеров** ведущему производителю приборов учета электроэнергии

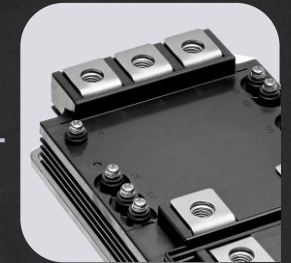


Офсетный контракт с Москвой на поставку **> 150 тыс. SAM-модулей**



Завершена разработка и запущено серийное производство **4 микроконтроллеров** на основе санкционно-устойчивой архитектуры RISC-V

Блоки и модули



60%

мощности новой фабрики в Алабушево обеспечено заказами

Алабушево

Плановая дата запуска

2026
/ 2 квартал



КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2025 ГОДА



Точное машиностроение



РАЗРАБОТКА ПЕРВЫХ В РФ КЛАСТЕРНЫХ СИСТЕМ

для плазмохимического
осаждения (ПХО) и травления
(ПХТ) для техпроцесса 65-нм
на пластинах 300 мм



ЗАПУСК УСТАНОВКИ ЭПИТАКСИИ GAN

в серийное производство



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

60,1

млрд ₽

Направлено на программу развития⁽¹⁾ 2023 — 2025 гг.

550+

Единиц технологического оборудования

Внедрено в рамках технологического перевооружения

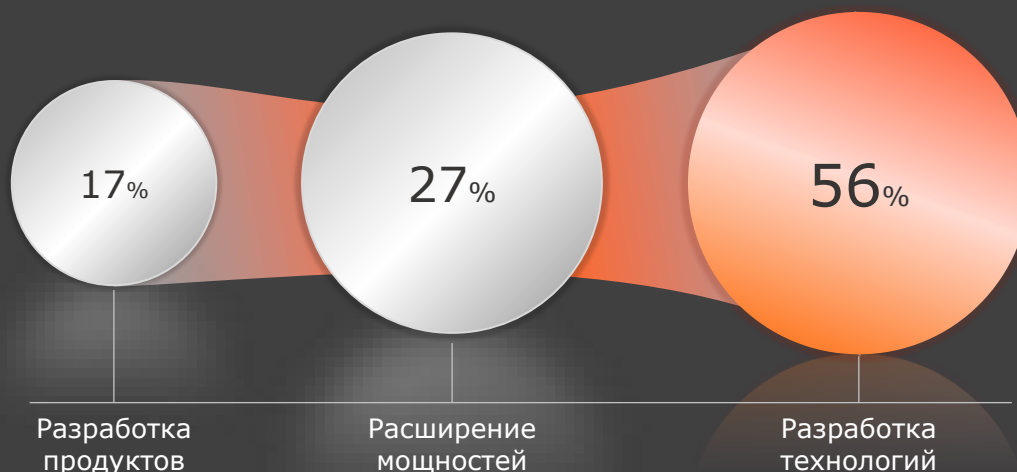
20,3

млрд ₽

инвестиции 2025 г.

79%

доля льготных источников финансирования в структуре программы развития 2025 г.



Крупные инвестиционные проекты 2024-2025 гг.

- Создание линий сборки микросхем в пластик
- Расширение производства высокотехнологичных металлокерамических корпусов
- Создание серийного производства, тестирования и сертификации устройств связи
- Расширение кристалльного производства Ø 200 мм
- Запуск производства модулей и блоков

(1) Программа развития включает в себя CAPEX по МСФО и заказные ОКР



ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 2025 Г.

01

Замедление темпов промышленного производства

Сокращение спроса в отраслях-потребителях продукции

02

Тренд на оптимизацию рабочего капитала

Сокращение среднего уровня запасов у покупателей

03

Перенос / корректировка инвестиционных программ в таких отраслях экономики, как –

Автопром, авиастроение, железнодорожный транспорт, сельхоз. техника



КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2025 Г.

● Выручка

38,6 млрд
₽

● EBITDA

4,9 млрд
₽

● Чистый убыток

-2,3 млрд
₽

● Рентабельность
по EBITDA

13 %



Финансовая устойчивость обеспечена низкой эффективной ставкой

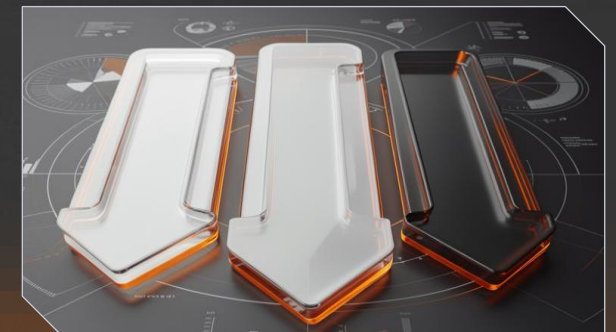
9,2%

средняя ставка
по портфелю



2,7x

соотношение
скорректированного
чистого долга / EBITDA



ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

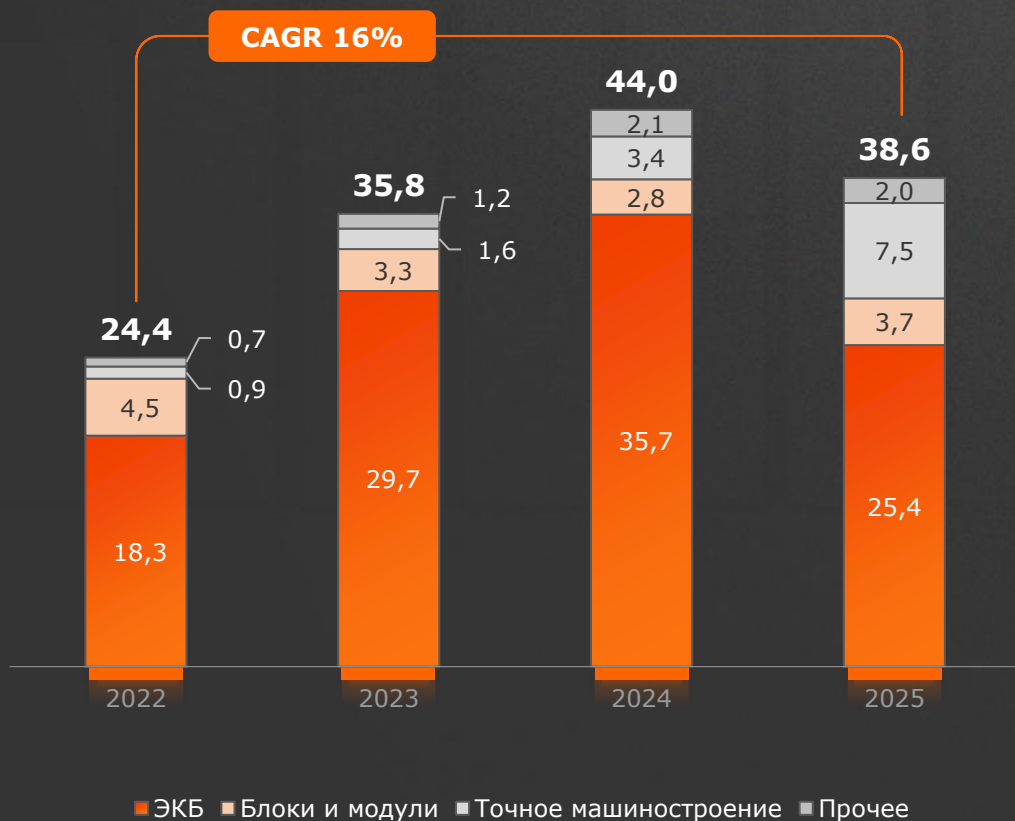




ВЫРУЧКА

Динамика выручки

млрд ₽ | 2025



Динамика выручки по основным сегментам

млрд ₽ | 2025 к 2024



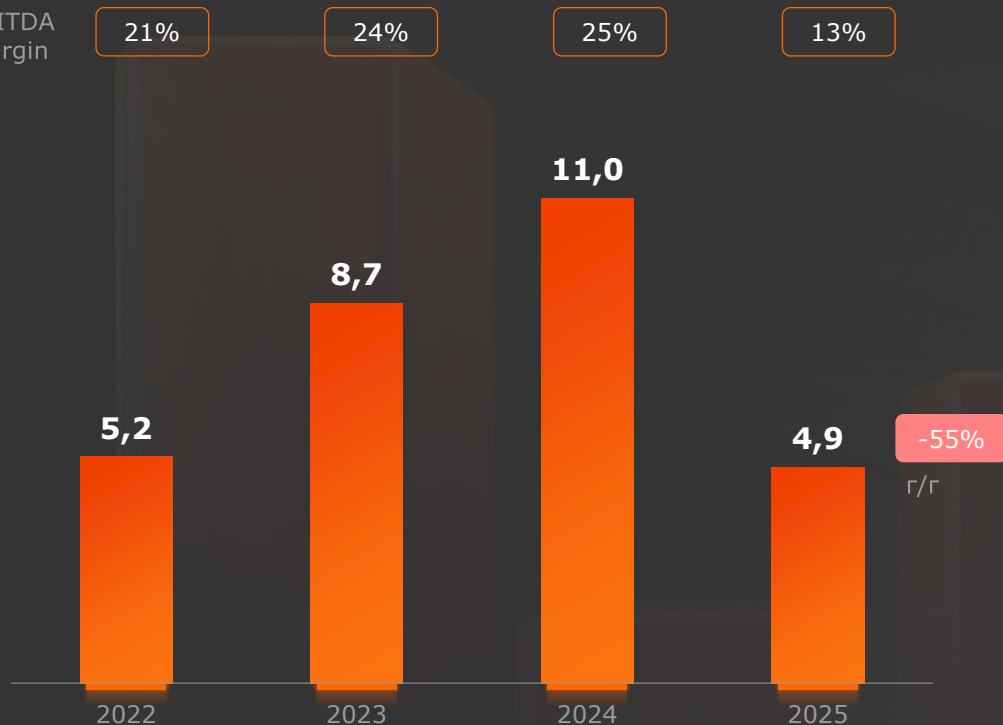


EBITDA

EBITDA

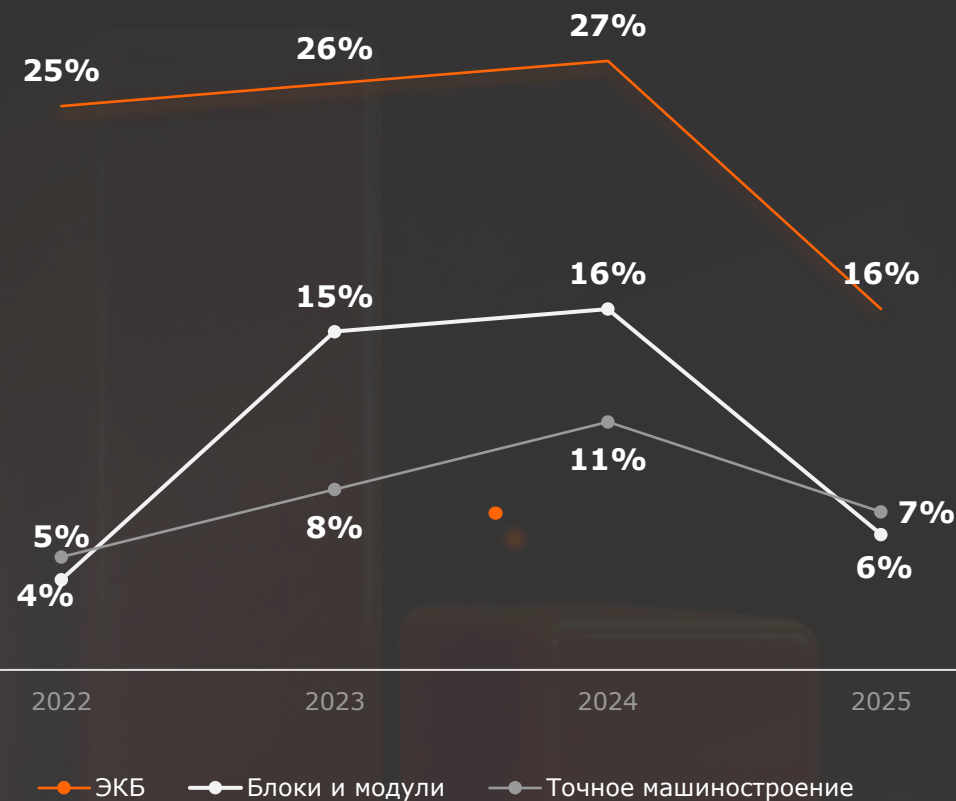
млрд ₹ | 2025

EBITDA margin



EBITDA margin по направлениям

%



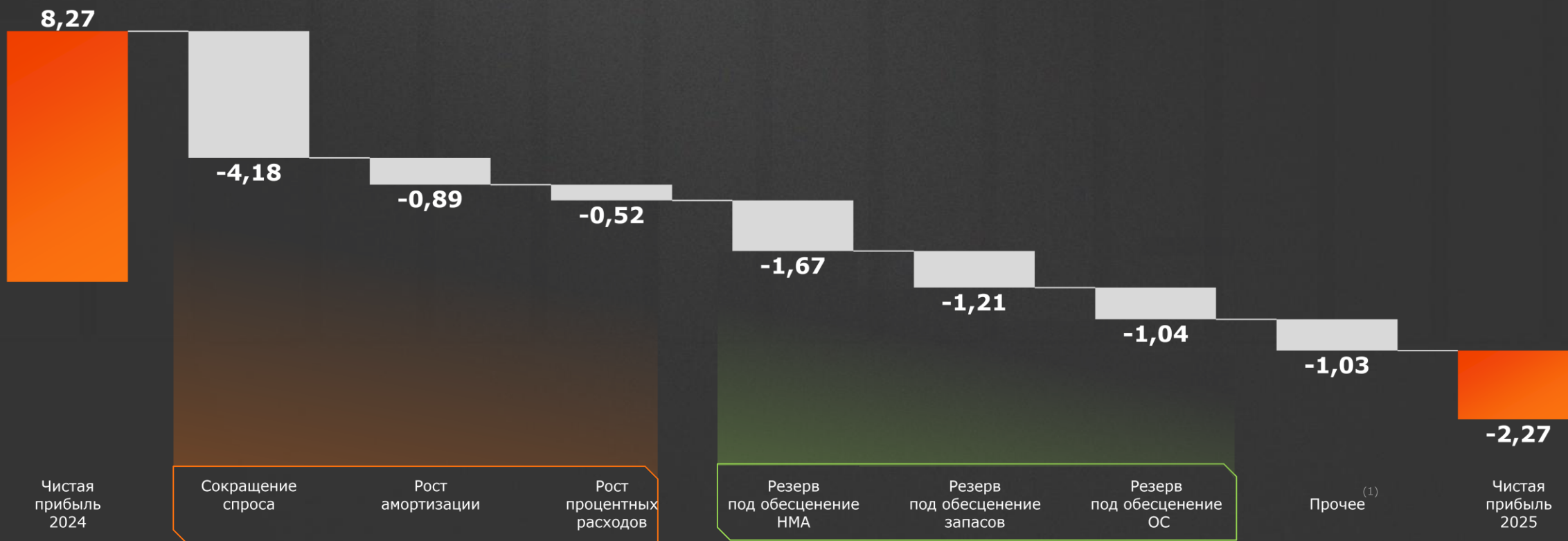


ФАКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ НА ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ

Факторный анализ динамики чистой прибыли

млрд ₹ | 2024 VS 2025

Операционные факторы Неоперационные факторы



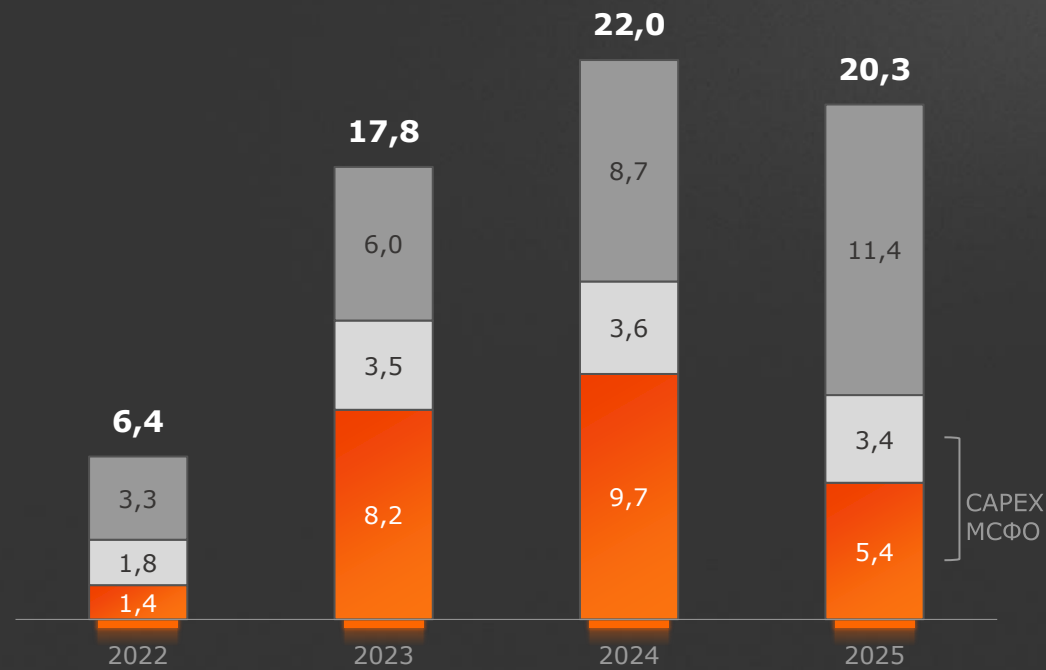
(1) Прочее включает курсовые разницы, резервы под штрафы и другие статьи



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Программа развития по направлениям

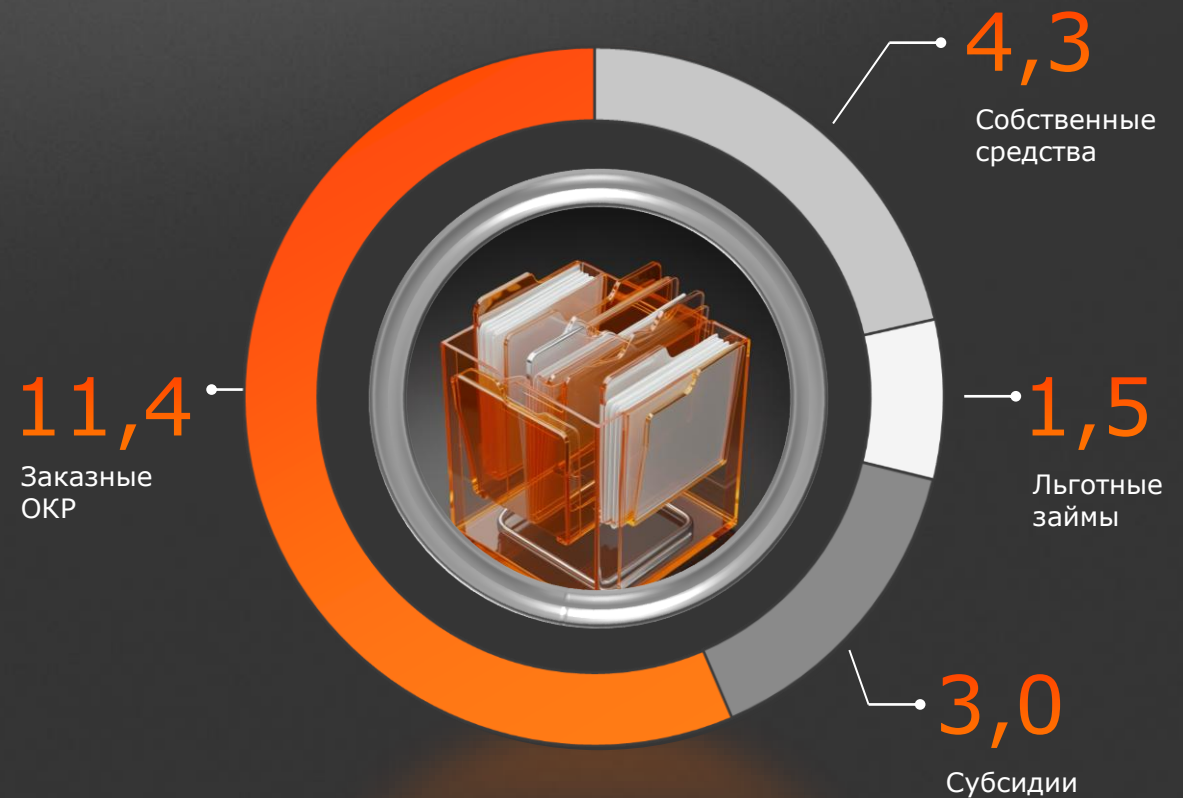
млрд ₽ | 2025



■ Расширение мощностей ■ Разработка продуктов ■ Разработка технологий

Источники программы развития

млрд ₽ | 2025



11,4
Заказные ОКР



КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Долговой портфель

млрд ₹ | 2025

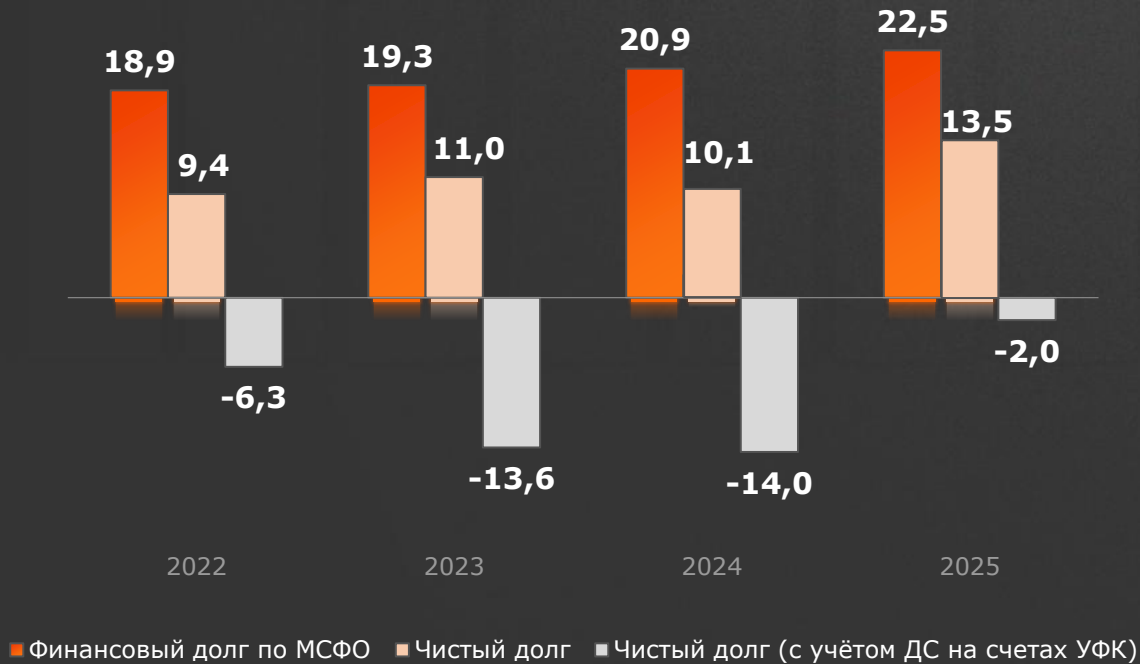
Net debt/
EBITDA

1,8x

1,3x

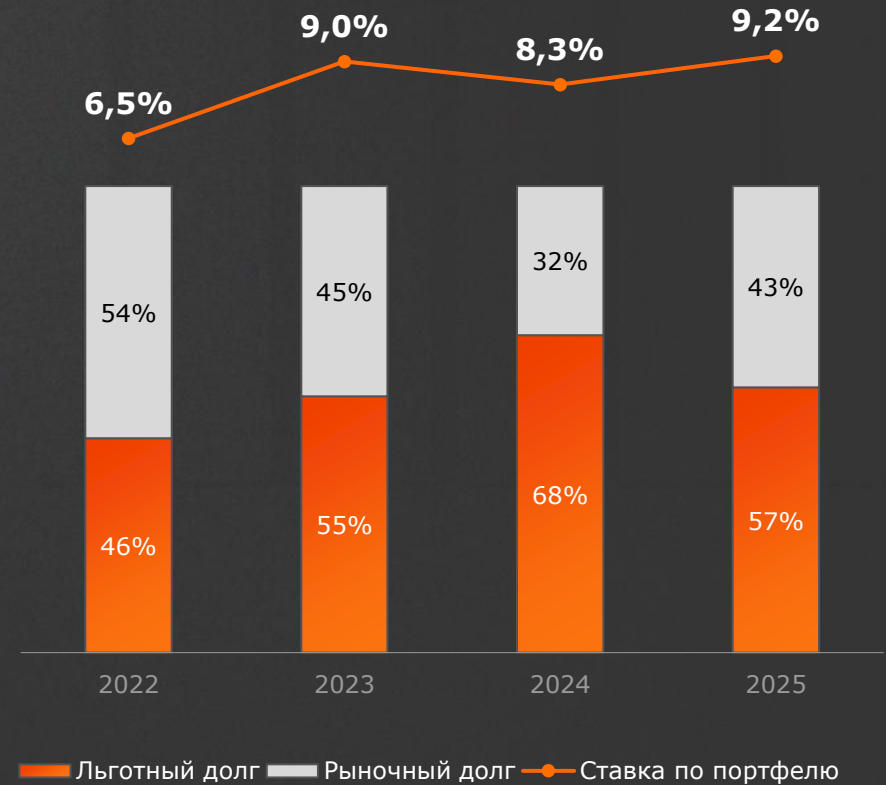
0,9x

2,7x



Структура долга по условиям привлечения

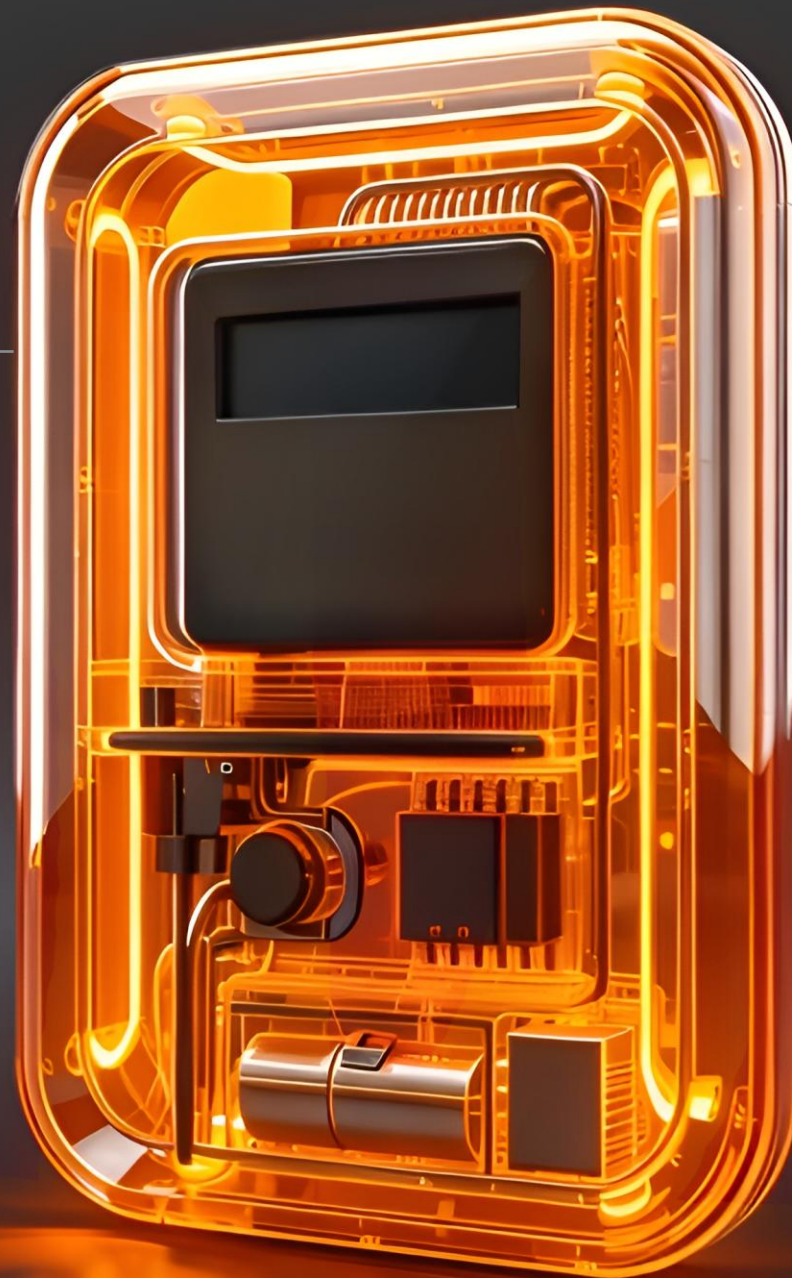
%



ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Электронная
компонентная
база





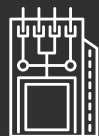
ПРИБОРЫ УЧЕТА: ОБЪЁМ РЫНКА

Компания вышла на рынок умных приборов учета

1 000 000

микроконтроллеров

заключен контракт на поставку в 2025 г.



Оценка рынка ЭКБ для приборов учета в денежном выражении¹

178,8 млрд
₽

до 2030



2025

24,9 млрд
₽

(1) Исходя из доли ЭКБ в стоимости прибора учёта в 35%



РАЗВИТИЕ ГК «ЭЛЕМЕНТ» В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ РЫНКУ СЧЁТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

План 2026

2 млрд ₽
12 млн МСХ

План 2027

5 млрд ₽
35 млн МСХ

К 2027 году ГК «Элемент» готова предложить рынку значительную часть ассортимента продукции для закрытия требований российского законодательства

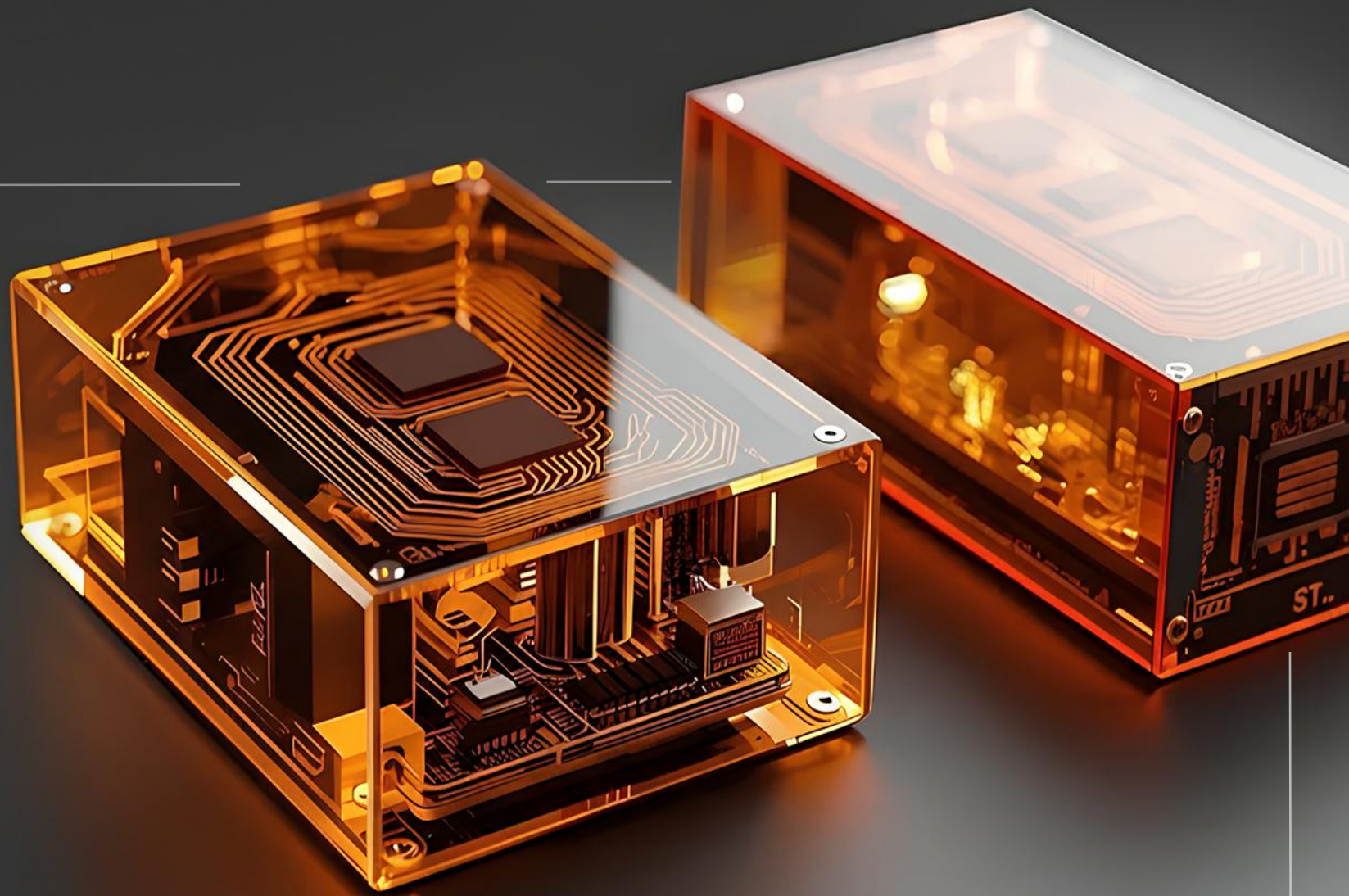


Достигается за счёт следующих компонентов:

	Баллы
Микроконтроллер K1921BF015	28
Интерфейс MIK3485S8RG	12
Стабилизатор напряжения MIK1117S-3.3ST3RG	5
Энергонезависимая память	12
АЦП	13
Реле управления нагрузкой	5

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Рынок модулей
и блоков





СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОДУЛЕЙ И БЛОКОВ НА НОВОЙ ПЛОЩАДКЕ В ОЭЗ «АЛАБУШЕВО»

Производственная площадка

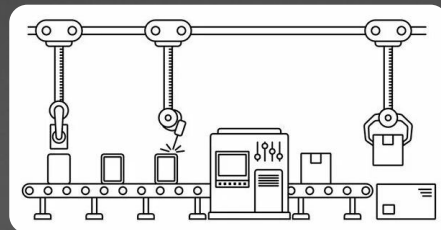
7,5 тыс. м²

Общая площадь здания



Запуск производства

Поставлено и проходит настройку производственное оборудование



Старт серийного производства

2 кв 2026

Модули и блоки



Емкость рынка

62 млрд руб

Целевая доля

40%

Производственные мощности площадки «Алабушево»

Блоки питания 550-3200 Вт

до 110 тыс. шт./г

Силовые модули 30-40 кВт

до 25 тыс. шт./г

Автомодули

до 50 тыс. шт./г

Преобразователи частоты (лифт)

до 30 тыс. шт./г



СИЛОВЫЕ МОДУЛИ И БЛОКИ ПИТАНИЯ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ

Телеком



Вендоры БС

Контрактация и работа с 4 из 5 российских вендоров базовых станций

4/5

RRU БС

Целевой рынок

60 млрд ₽

Целевая доля

20 %

Центр проектирования в г. Томск

01

Участие в Кластере электроники и беспилотных технологий на территории Томской области в качестве соисполнителя с основными якорными заказчиками

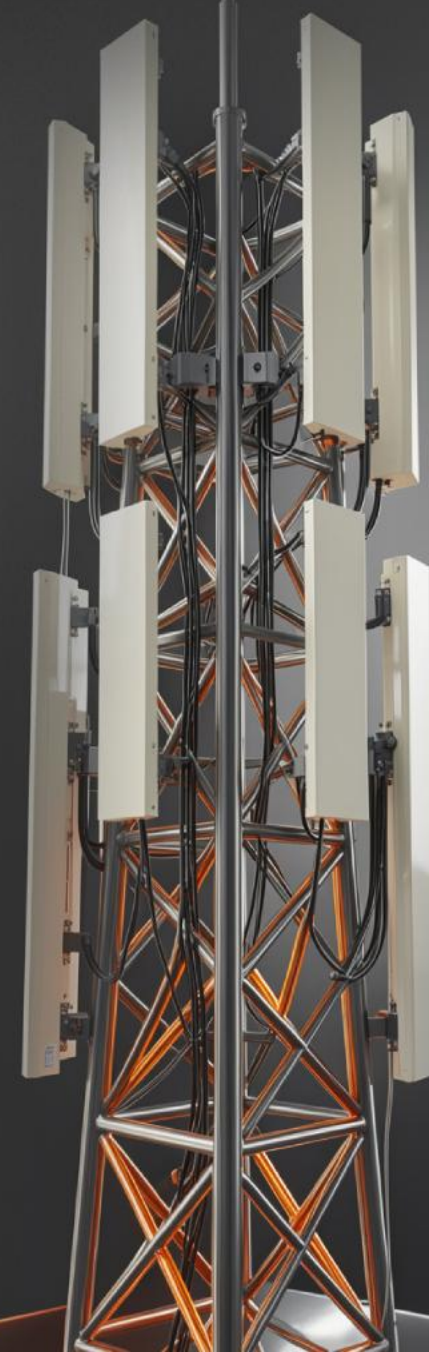
02

Ведется анализ схемотехнических решений DC/DC преобразователя мощностью 800 Вт с учетом применимости отечественной ЭКБ

03

Разработка и тестирование российского прототипа модуля управления питанием в граничных режимах работы

Исполнены обязательства по сборке, тестированию и настройке радиомодулей одного из региональных операторов связи



ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Точное
машиностроение





ПЕРВЫЙ ШАГ К ТЕХНОЛОГИИ <90 НМ

В контуре группы («НИИТМ» совместно с «НИИМЭ») запущено первое российское оборудование для плазменного травления и осаждения для пластин 300 мм и технологий 65 нм и ниже

14

процессов



Реализовано в рамках работы 2-х кластеров травления и осаждения

ЗАПУЩЕНО 2 НОВЫХ ПРОЕКТА РАЗРАБОТКИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЭЛЕКТРОННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»

Промышленно-ориентированный кластерный комплекс нанесения слоев алюминиевой металлизации методом PVD

Автоматизированная установка измерения рассовмещения топологических слоев на кремниевых пластинах диаметром 150, 200 мм

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Модули травления Si, poly-Si, Al, TiNx, диэлектриков (SiOx и др.), удаление резиста



Система автоматического окончания процесса травления (end-point)



Модули PECVD осаждения SixNy, SiOx (SiH4/N2O), SiOx из TEOS, SACVD (TEOS/O3)

Результат сравнимый с мировым уровнем

< 2%^(σ)

Неравномерность осаждения

В 2026 ГОДУ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ ДЕМО-МАКЕТЫ УСТАНОВОК ЛАБОРАТОРНОГО ЭЛЕКТРОННОГО МИКРОСКОПА И ОПТИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ НА 1 МКМ

МУХА

Напольный лабораторный растровый электронный микроскоп для научных и промышленных задач

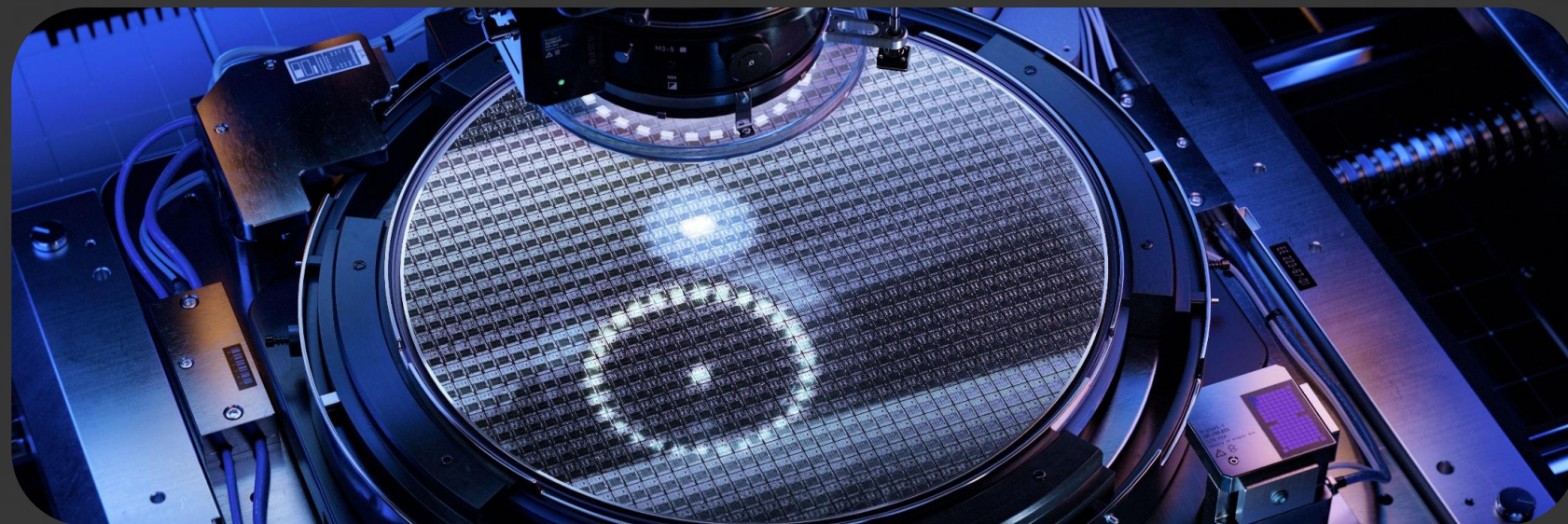
МАЛИНОВКА

Установка макроинспекции Si пластин D до 150 мм с топологическими структурами в светлом поле



СОЗДАНЫ ОСНОВЫ ДЛЯ СИЛОВОЙ СВЧ-ЭЛЕКТРОНИКИ

Получены первые базовые и транзисторные структуры GaN на подложках Si на российском оборудовании



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Возможность обработки пластин диаметром от 50 до 200 мм



In situ контроль толщины и прогиба структуры во время роста



Легирование Fe, C, Mg для получения буферных слоев и слоев p-типа

2



установки

Поставлены потребителям для проведения технологических работ

< 2%



Неоднородность по составу AlGaN и площади структуры 200 мм



ОТКРЫТО 4 НОВЫХ R&D ЦЕНТРА

01

Центр
разработки
в Зеленограде



02

Измерительная
лаборатория
в Новосибирске



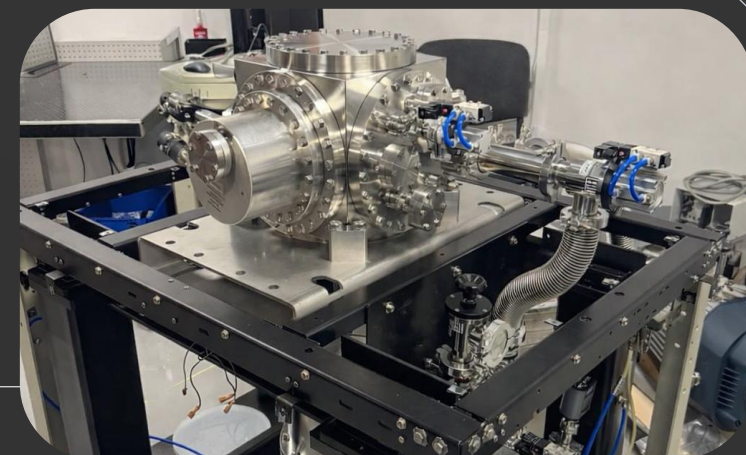
03

Лаборатория
и Центр
разработки
в Москве



04

Лабораторные
испытания
в Троицке





Спасибо за внимание

Команда IR

ПАО «Элемент»

Электронный адрес: ir@elementec.ru

123317, Москва, Пресненская набережная, д.12

Башня Федерация «Восток», 20 этаж

www.gkelement.ru